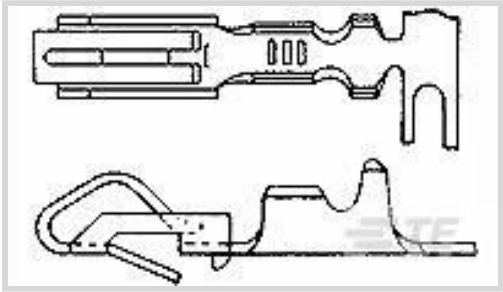




连接器 > PCB 连接器 > 板对板连接器 > 板对板连接器端子



端子类型: 无极性

连接器系统: 线到板

端子接触部电镀材料: 预镀锡

Wire Size: .2 – .8 mm²

产品特性

产品类型特性

连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

接触件特性

PCB 端子端接区域电镀材料	预镀锡
端子基材	磷青铜
端子类型	无极性
端子接触部电镀材料	预镀锡
端子方向	直式
端子额定电流（最大值）	6 A

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

壳体內的端子定位器类型	卡口
带导线绝缘	带有
PCB 安装固定	不带
连接器安装类型	板安装

尺寸

Accepts Wire Insulation Diameter Range	2.54 mm[.1 in]
Wire Size	.2 – .8 mm²



使用环境

工作温度范围	-55 – 105 °C[-55 – 105 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装数量	1000
封装方法	Loose Piece

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211） SvHCs候选清单的声明更新至: 2020年1月（205） 超过限值的SVHC： Not Yet Reviewed
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 640136-2
02P EDGE CONN HSG, BIF-LEAF

TE 产品编号 91597-1
CCII SL-156 REC 24-18 ASSY

TE 产品编号 91597-3
CCII SL-156 REC 24-18 HEAD

客户还购买了

TE 产品编号201098-1
MIN SOCKET

TE 产品编号2-1393143-0
27E168=SOCKET,KU93,11,PC,NYL

TE 产品编号1618113-1
WUVT3-120=WILMAR
UNDERVOLTAGE

TE 产品编号4-1423152-7
2112D4NF=RLY,MINI,2P,28V,30S

TE 产品编号4-1879502-2
CRGH2512 5% 680K 2W

文档

产品图纸

BIF-LEAF CONT PTPPHBZ LP 24-18

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_350011-3_J.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350011-3_J.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_350011-3_J.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

Bifurcated Leaf Contact

英文版本

应用规格

英文版本